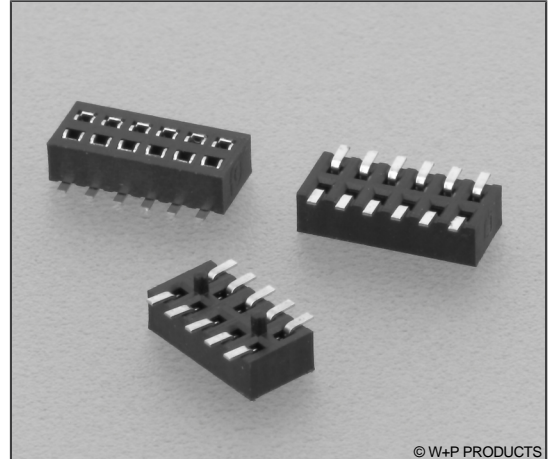


## SMT-Buchsenleisten RM 1,27mm, stehend, 2-reihig – BH 2,2mm, von unten steckbar SMT Female Headers, 1.27mm Pitch, Vertical, Double Row – 2.2mm, Bottom Entry

### Technische Daten / Technical Data

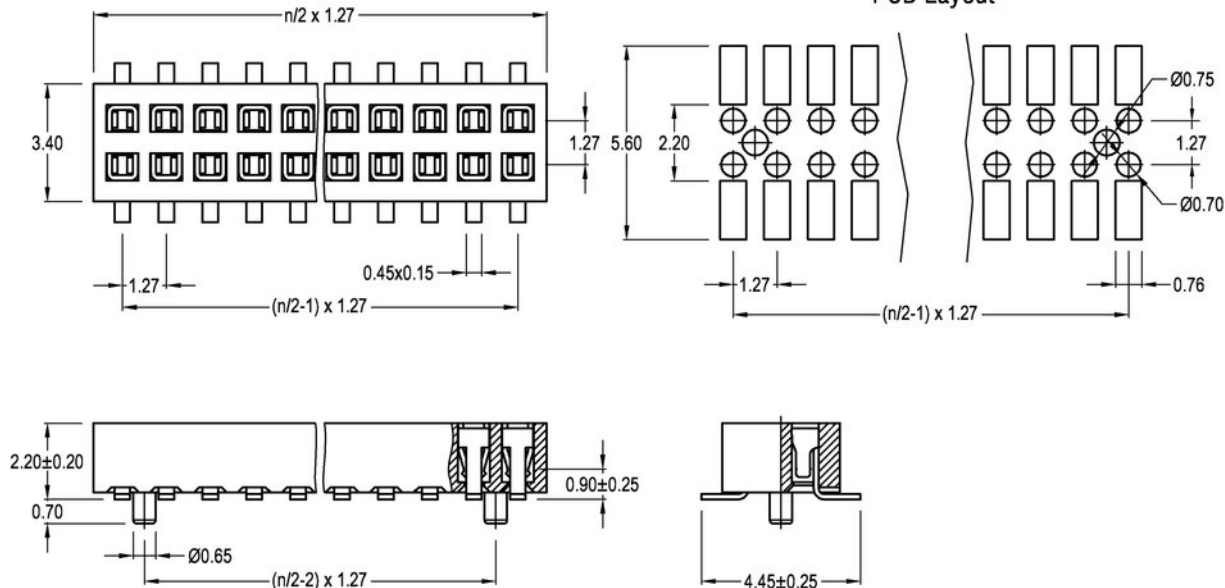
|                       |  |
|-----------------------|--|
| Isolierkörper         | Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0          |
| Insulator             | Thermoplastic, rated UL94 V-0                        |
| Kontaktmaterial       | Kupferlegierung                                      |
| Contact Material      | Copper alloy   |
| Kontaktoberfläche     | Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm)     |
| Contact Surface       | Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm) |
| Durchgangswiderstand  | < 20mΩ   |
| Contact Resistance    | < 20mΩ   |
| Isolationswiderstand  | > 1000MΩ   |
| Insulation Resistance | > 1000MΩ   |
| Spannungsfestigkeit   | 500V <sub>AC</sub>                                   |
| Test Voltage          | 500V <sub>AC</sub>                                   |
| Nennstrom             | 1A   |
| Current Rating        | 1A   |
| Temperaturbereich     | -40°C ... +105°C                                     |
| Temperature Range     | -40°C ... +105°C                                     |
| Verarbeitung          | Reflow-Lötverfahren                                  |
| Processing            | Reflow soldering                                     |



© W+P PRODUCTS

Doppelfederkontakte für  
Vierkantstifte 0,40mm.  
Dual beam contacts accept  
0.40mm square pins.

### PCB Layout



|               |  |   |   |                                   |
|---------------|--|---|---|-----------------------------------|
| <b>Series</b> | <b>Contacts*</b>                               | <b>Plating*</b>   | <b>Locating Pegs*</b>   | <b>Packaging*</b>                 |
| <b>6061</b>   | <b>040</b><br>006-080 Zweireihig<br>Double row | <b>00</b><br>00 Vergoldet<br>Gold plated<br>50 Verzinkt<br>Tin plated | <b>10</b><br>00 Ohne Pos.hilfen<br>W/o loc. pegs<br>10 Mit Pos.hilfen<br>With loc. pegs | <b>PPST</b><br>ST<br>PPST<br>PPTR |

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -  
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** -  
please replace by your specifications.

### Lieferformen / Packaging Options:

**ST** In Stangen ohne Pick&Place-Pads / In tubes w/o Pick&Place-Pads  
**PPST** In Stangen mit P&P-Pads / In tubes with P&P-Pads  
**PPTR** Tape & Reel mit P&P-Pads / Tape & Reel with P&P-Pads

# Informationen zum Reflow-Lötverfahren

## Reflow Soldering Information

### Reflow-Lötempfehlung

#### Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

| Profileigenschaft                    | Kennwert     |
|--------------------------------------|--------------|
| Temperatur Minimum $T_{Smin}$        | 150°C        |
| Temperatur Maximum $T_{Smax}$        | 200°C        |
| Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$          | 60-180s      |
| Temperatur Lötbereich $T_L$          | 217°C        |
| Verweildauer oberhalb $T_L$          | 60-180s      |
| Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$        | max. 3°C / s |
| Höchsttemperatur $T_P$               | 260°C ±5     |
| Dauer Höchsttemperatur               | 20-40s       |
| Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$ | 6°C / s      |
| Dauer 25°C - Höchsttemperatur $T_P$  | Max. 8 min   |

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

| Profile Feature                      | Key Values   |
|--------------------------------------|--------------|
| Minimum Temperature $T_{Smin}$       | 150°C        |
| Maximum Temperatur $T_{Smax}$        | 200°C        |
| Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$       | 60-180s      |
| Soldering Range Temperature $T_L$    | 217°C        |
| Duration above $T_L$                 | 60-180s      |
| Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$        | max. 3°C / s |
| Peak Temperature $T_P$               | 260°C ±5     |
| Duration Peak Temperature            | 20-40s       |
| Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$ | 6°C / s      |
| Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$     | Max. 8min    |

